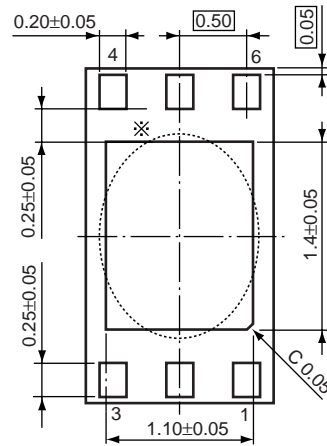
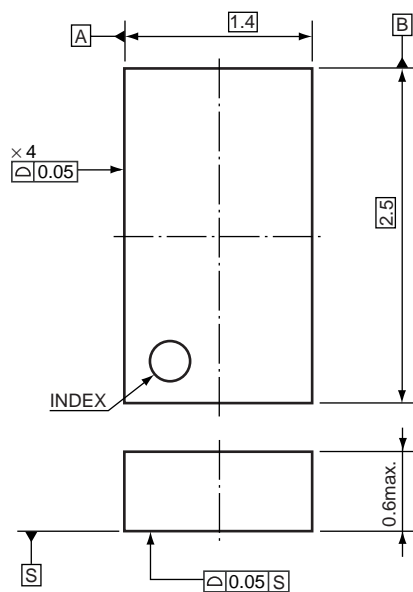


DFN(PLP)2514-6

単位:mm

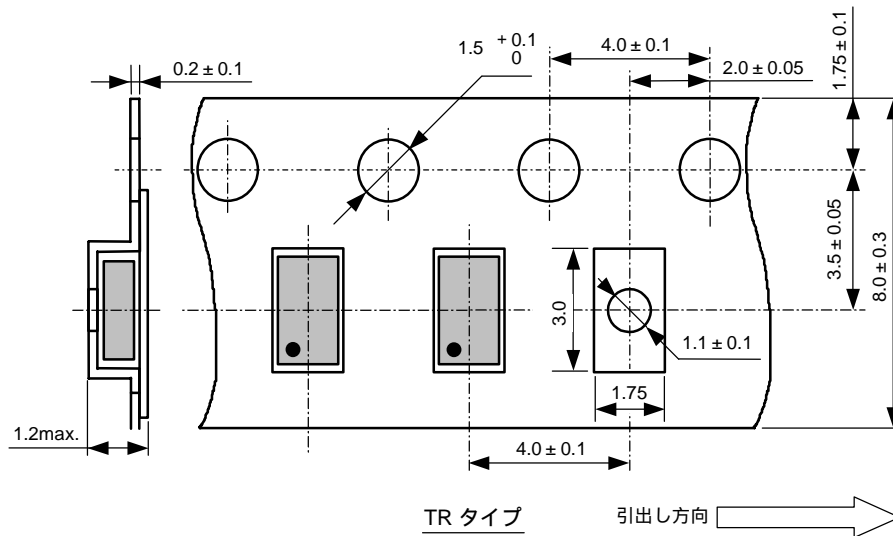
パッケージ外形図



裏面図

※ 部分にあるタブは電源電位 (+ or - はチップ裏面に接続されている為、製品により異なります) になっています。基板設計の際に他の配線とショートしない様に注意下さい。

テーピング仕様

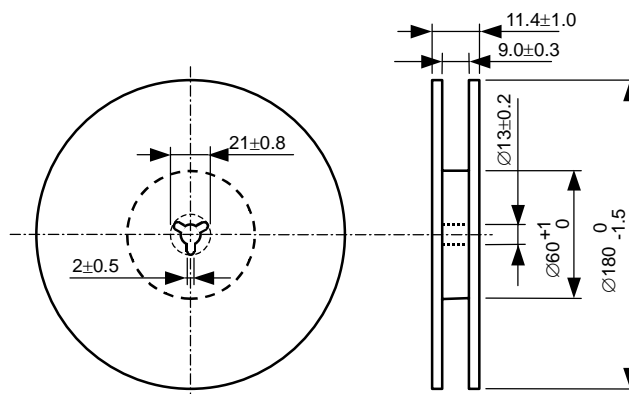


TR タイプ

引出し方向

テーピングリール外形図 リユースリール(EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール = 5000 個)



許容損失について (DFN(PLP)2514-6)

DFN(PLP)2514-6パッケージの許容損失について特性例を示します。

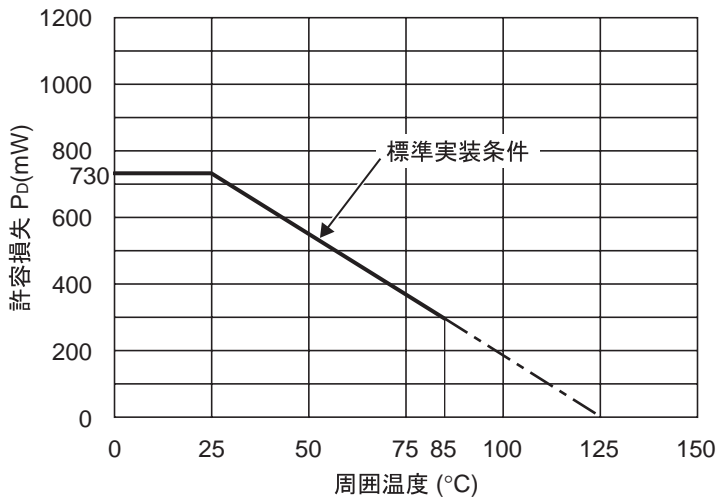
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

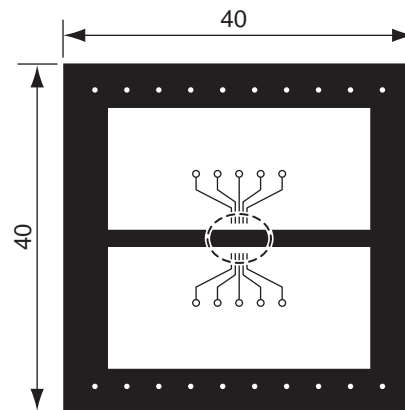
| 標準実装条件 | |
|--------|---------------------|
| 測定状態 | 基板実装状態 (風速 0m/s) |
| 基板材質 | ガラスエポキシ樹脂 (両面基板) |
| 基板サイズ | 40mm × 40mm × 1.6mm |
| 配線率 | 表面 約 50%、裏面 約 50% |
| スルーホール | 直径 0.54mm × 30 個 |

測定結果 (T_{opt}=25℃, T_{jmax}=125℃)

| 標準実装条件 | |
|--------|---|
| 許容損失 | 730mW |
| 熱抵抗値 | $\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/0.73\text{W} = 137^\circ\text{C/W}$ |



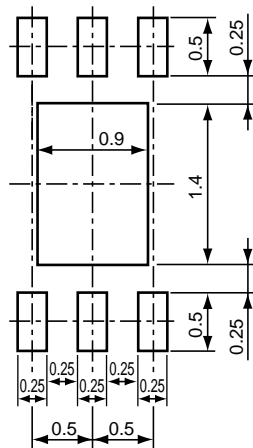
許容損失特性



測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位: mm)

基板パッド推奨寸法 (DFN(PLP)2514-6)



(単位: mm)